

# Sensor inductivo

con distancias de conmutación aumentada

## I12H032

Referencia

weproTec



- Distancia de conmutación aumentada
- Distancia de montaje inferior gracias a weproTec de wenglor
- Indicación de avería integrada
- Innovadora tecnología de conmutación ASIC

Asegurar a los sensores inductivos con distancias de conmutación aumentadas un diseño robusto, un montaje más sencillo y valores de medida eficaces. Una distancia grande hace que los tipos de sensores adicionales sean innecesarios, ya que las aplicaciones especiales pueden soltarse. Gracias a ASIC y weproTec de wenglor, la nueva generación ofrece junto con el funcionamiento sin problemas de más sensores en un espacio limitado, la posibilidad de reconocer los errores puntuales en el sistema.

### Datos técnicos

#### Datos del inductivo

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Distancia de conmutación                      | 8 mm           |
| Factores de corrección acero inox V2A/CuZn/Al | 1,07/0,47/0,45 |
| Montaje                                       | casi enrasado  |
| Montaje A/B/C/D en mm                         | 12/26/24/4     |
| Montaje B1 en mm                              | 0...10         |
| Histéresis de conmutación                     | < 10 %         |

#### Datos eléctricos

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Tensión de alimentación                          | 10...30 V DC |
| Consumo de corriente (Ub = 24 V)                 | < 14 mA      |
| Frecuencia de conmutación                        | 450 Hz       |
| Temperatura de desvío                            | < 10 %       |
| Rango de temperatura                             | -40...80 °C  |
| Caída de tensión salida de conmutación           | < 1 V        |
| Corriente de conmutación / salida de conmutación | 150 mA       |
| Corriente residual a la salida                   | < 100 µA     |
| Protección cortocircuitos                        | sí           |
| Protección polaridad invertida y sobrecarga      | sí           |
| Categoría de protección                          | III          |

#### Datos mecánicos

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Carcasa             | CuZn, niquelado  |
| Clase de protección | IP67             |
| Conexión            | M12 × 1; 3-pines |

#### Datos técnicos de seguridad

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 3706,54 a |
|------------------------|-----------|

#### Función

|                  |    |
|------------------|----|
| Display de error | sí |
|------------------|----|

NPN NO

Nº Esquema de conexión

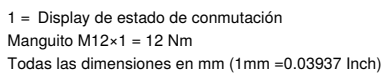
302

Nº Conector adecuado

2

Nº Montaje adecuado

170 | 172



### Aclaración de símbolos

The image contains three technical diagrams illustrating different types of vias in a multi-layer printed circuit board (PCB):

- Top Diagram:** Shows a cross-section of a multi-layer PCB with a microvia. The microvia is a small hole drilled into the top layer, with its depth labeled 'A'. The diameter of the microvia is labeled 'B'. The diameter of the microvia opening is labeled 'C'. The diameter of the microvia barrel is labeled 'D'.
- Bottom Left Diagram:** Shows a cross-section of a multi-layer PCB with a through-hole via. The diameter of the through-hole via is labeled  $1,5 \times Sn$ , where 'Sn' represents the thickness of the surface plating.
- Bottom Right Diagram:** Shows a cross-section of a multi-layer PCB with a buried via. The diameter of the buried via is labeled 'B1'.